

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

DD 400 S 17 K6 B2

eupec

vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V_{CES}	1700	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	400	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	800	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0V, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	70	kA^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ min.}$	V_{ISOL}	4	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 400A, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	V_F	-	2,2	2,6	V
	$I_F = 400A, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	2,05		V
Sperrstrom reverse current	$V_R = 1700V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_R	-	0,1	1	mA
	$V_R = 1700V, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	10		mA
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 400A, -di_F/dt = 2800A/\mu\text{sec}$	I_{RM}	-	240	-	A
	$V_R = 900V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			340	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 400A, -di_F/dt = 2800A/\mu\text{sec}$	Q_r	-	50	-	μAs
	$V_R = 900V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			115	-	μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 400A, -di_F/dt = 2800A/\mu\text{sec}$	E_{rec}	-	27	-	mWs
	$V_R = 900V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			55	-	mWs
Modulinduktivität stray inductance module	pro Diode / per Diode	L_{SAC}	-	20	-	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	pro Zweig / per arm	$R_{CC'+EE'}$	-	0,16	-	m Ω

prepared by: O. Schilling	date of publication: 12.11.1998
approved by: Chr. Lübke; 26.07.99	revision: 1

vorläufige Daten
preliminary data

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode, DC	R_{thJC}	-	-	0,068	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}	-	0,016	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				AIN	
Kriechstrecke creepage distance				15	mm
Luftstrecke clearance				10	mm
CTI comperative tracking index		min.		275	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1		5	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M8	M2		8 - 10	Nm
Gewicht weight		G		1050	g

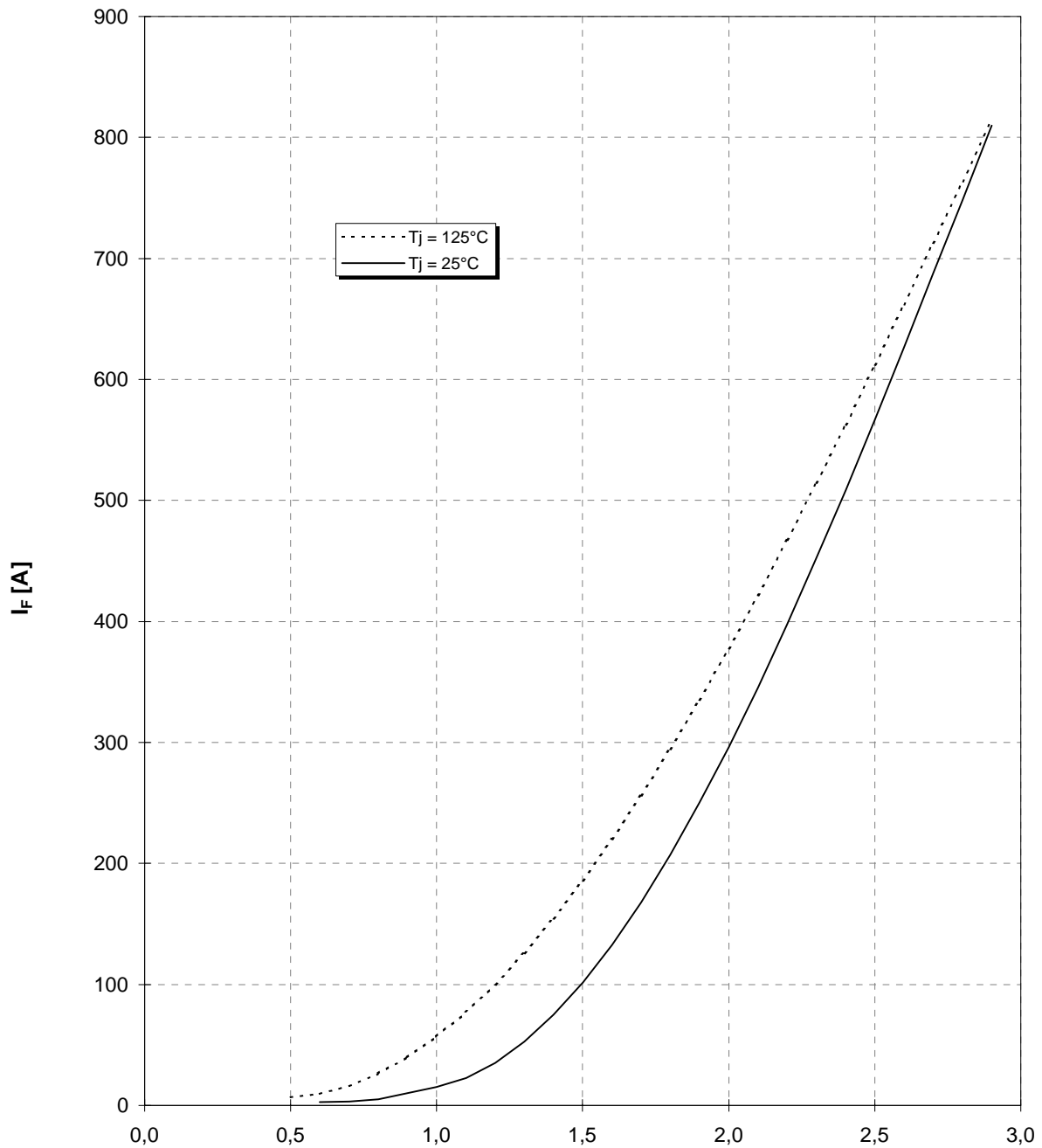
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

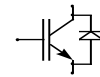
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

vorläufige Daten
preliminary data

Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$$I_F = f(V_F)$$

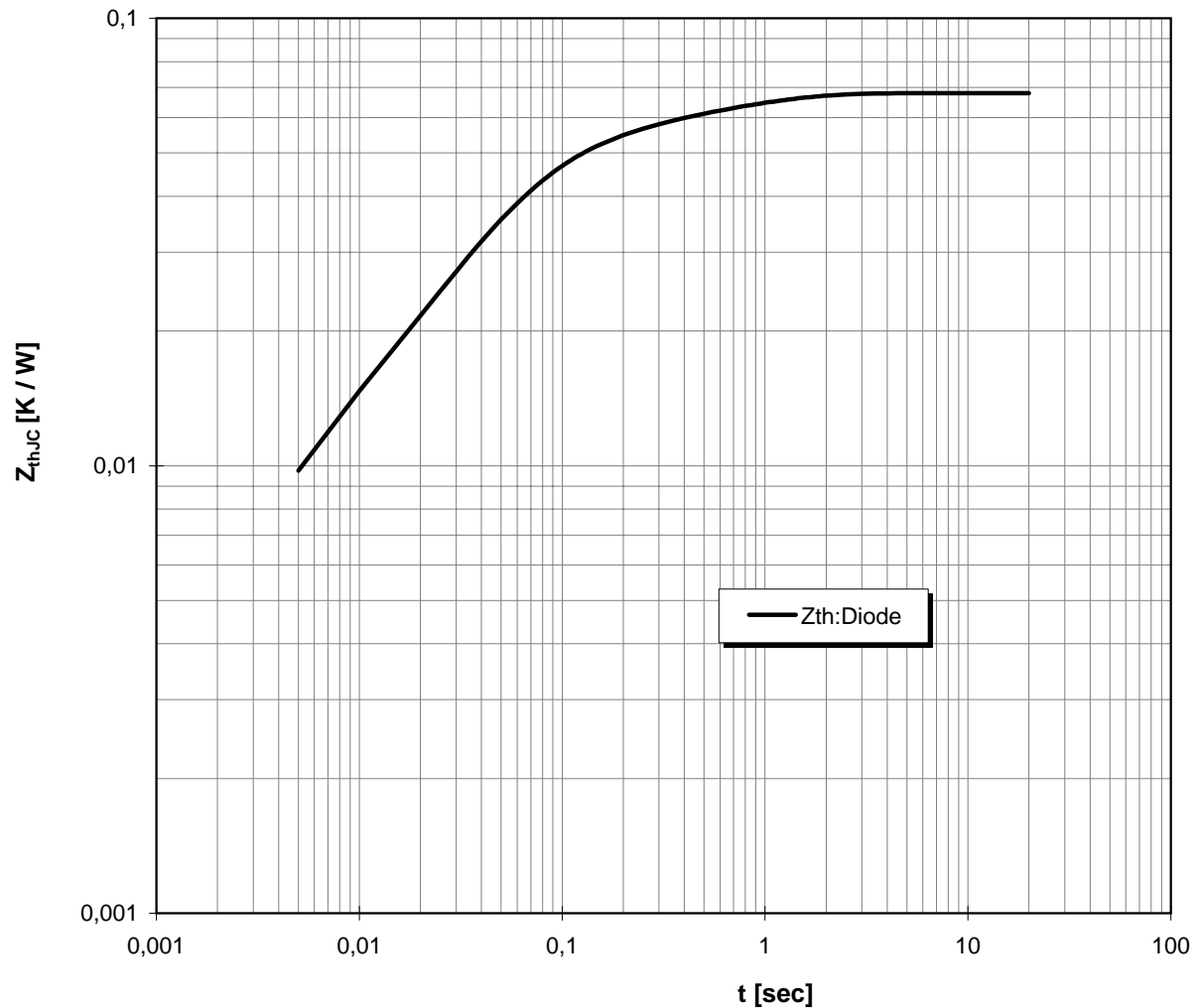




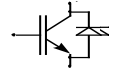
vorläufige Daten

preliminary data

Transienter Wärmewiderstand $Z_{thJC} = f(t)$
Transient thermal impedance



i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : Diode	6,7	36,44	12,44	12,42
τ_i [sec] : Diode	0,003	0,045	0,45	0,75



Äußere Abmessungen / external dimensions

